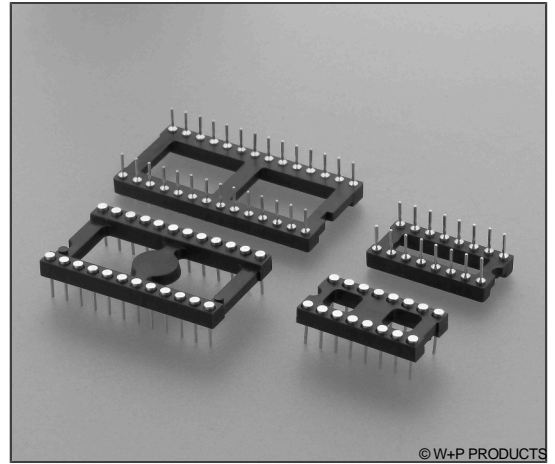


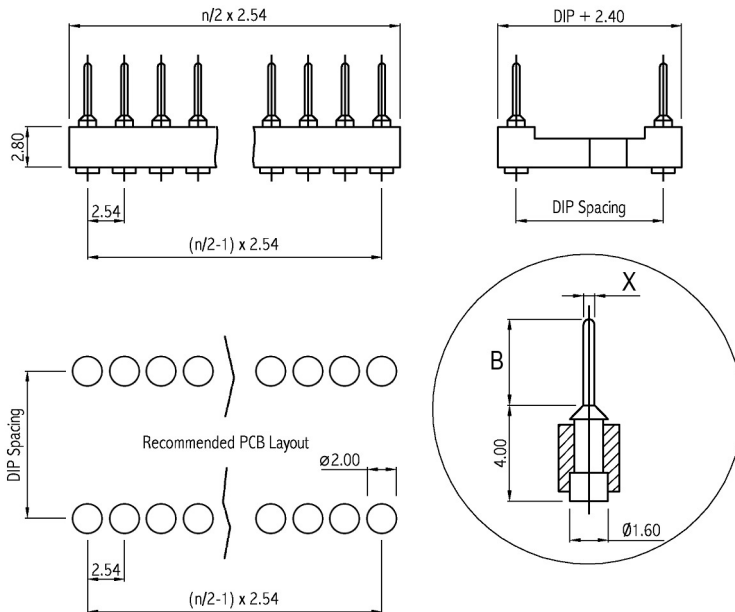
SMT IC-Adapterfassungen RM 2,54mm – Präzisionskontakte schwimmend gelagert SMT IC-Pin Sockets 2.54mm Pitch – Floating Screw Machined Contacts

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Messing gedreht <i>Screw machined brass</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to options (see below), over Ni</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 10 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1 kV RMS
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	100 V RMS / 150 V DC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1 A für Pin X=0,47mm (für X=0,76mm bis zu 3 A) <i>1 A for pin X=0.47mm (for X=0.76mm up to 3 A)</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55 °C ... +125 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>

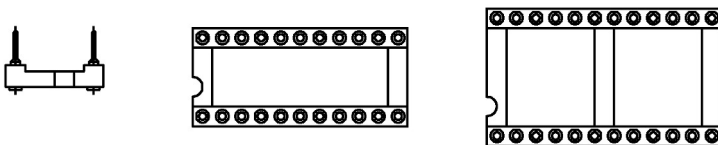


© W+P PRODUCTS

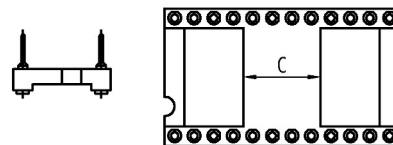


DIP Spacing	Manual Assembly	Automatic Assembly	Dim C [mm]
2	10	---	closed frame
3	04-10	04-10	closed frame
3	12-18	14-18	5.3
3	20-24 28	20 24 28	8.3
4	20-24 28 32	---	---
6	36 40 42 48-52	28 32 40 42	10.0

Manual Assembly



Machine Assembly



Series	Contacts*	DIP Spacing*	Assembly*	Plating*	Package
3232	24 04-52 Nach Tabelle See table	6 2 5.08mm 3 7.62mm 4 10.16mm 6 15.24mm	1 1 Für Handbestückung B=3,6/X=Ø0,47mm For manual assembly B=3.6/X=Ø0.47mm 2 Für Automatenbestückung B=3,6/X=Ø0,47mm For machine assembly B=3.6/X=Ø0.47mm 3 Für Handbestückung B=3,6/X=Ø0,76mm For manual assembly B=3.6/X=Ø0.76mm 4 Für Automatenbestückung B=3,6/X=Ø0,76mm For machine assembly B=3.6/X=Ø0.76mm 5 Für Handbestückung B=5,0/X=Ø0,76mm For manual assembly B=5.0/X=Ø0.76mm 6 Für Automatenbestückung B=5,0/X=Ø0,76mm For machine assembly B=5.0/X=Ø0.76mm	00 Vergoldet Gold plated 10 Au 0.25µm (Option) 50 Verzinkt Tin plated	ST Verpackt in Stangen Packed in tubes TR Tape & Reel (Option) Tape & Reel (Option)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

